



DO NIEZWŁOCZNEJ PUBLIKACJI

Firma HiFlow Solutions zaprasza do spotkań 1:1 w czasie Digital Packaging Summit

[Warszawa 19 listopada 2020 r.] - HiFlow Solutions informuje, że w dniach 1-3 grudnia 2020 będzie brała udział w Digital Packaging Summit i zaprasza wszystkich producentów opakowań, którzy chcą zwiększyć efektywność produkcji, do bezpośrednich spotkań podczas tej imprezy.

HiFlow Solutions jest Srebrnym Sponsorem tego wydarzenia, którego szczegółowy program prezentowany jest na stronie organizatora <https://www.digitalpackagingsummit.com/agenda/>

Z uwagi na Covid19 tegoroczna edycja ma co prawda formę internetową, ale przygotowana przez organizatora platforma komunikacyjna pozwala na wygodny kontakt pomiędzy uczestnikami.

Impreza ta ma zainspirować społeczność druku opakowań do wdrażania najnowszych technologii w tej dziedzinie. Jest to doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi technologiami drukowania opakowań i porozmawiania z nami o tym, jak możemy pomóc ulepszyć Twój biznes.

Uczestnicy Digital Packaging Summit mający status VIP będą mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach 1:1 od 1 do 11 grudnia. Spotkania te będą odbywały się w godzinach od 13:30 do 17:00 czasu wschodniego USA.

Jack Lafler, Wiceprezes ds. Technologicznych wyjaśnia: *„Ta impreza jest przeznaczona dla klientów zainteresowanych nowymi technologiami w produkcji opakowań. Właśnie takim firmom dedykowany jest nasz nowoczesny system HiFlow. Szczególnie cenimy rozmowy z zarządami firm opakowaniowych, które doskonale rozumieją korzyści z wdrożenia naszego systemu. Dostrzegamy liczne synergie płynące z takich spotkań.”*

Już w tej chwili firma ma kilkunastu klientów umówionych na indywidualne spotkania zdalne. Kolejne zainteresowane osoby powinny zarejestrować się na stronie: <https://www.digitalpackagingsummit.com/attend/>. Wtedy możliwe będzie zaplanowanie dla nich indywidualnych spotkań oraz dyskusji z ekspertami HiFlow Solutions w zakresie produkcji opakowań.

„Podczas Digital Packaging Summit chcemy umożliwić wymianę doświadczeń naszych dotychczasowych klientów z ich odpowiednikami zainteresowanymi wdrożeniem systemu HiFlow (firmami opakowaniowymi działającymi w dokładnie tym samym obszarze, np. druk na aluminium, kartoniki farmaceutyczne itp.). W ten sposób nasi przyszli klienci będą mogli poznać działające w tych sektorach, wdrożone przez nas gotowe rozwiązania. Dodam, że nasza oferta obejmuje również dostosowanie systemu HiFlow do potrzeb i wymagań klienta, nie tylko w przypadku instalacji na jego serwerze lokalnym, ale także w chmurze Microsoft Azure” – uzupełnia Jack Lafler.

O tym dlaczego warto wziąć udział można przeczytać na:

<https://www.digitalpackagingsummit.com/why-attend/>

#####

HiFlow Solutions dostarcza systemy klasy MIS / MES, które pomagają producentom etykiet i opakowań oraz drukarzom działać bardziej wydajnie i zyskownie. Firma świadczy pełen zakres usług doradczych, wdrożeniowych oraz integracji systemów z maszynami, wykorzystując najnowocześniejsze technologie informatyczne i komunikacyjne do zwiększania wydajności, produktywności oraz rentowności. HiFlow Solutions od ponad 20 lat oferuje systemy zarządzania ponad 100 klientom w wielu krajach świata. Jej międzynarodowa siedziba sprzedaży znajduje się w Miami (USA), a oddziały w Warszawie i Brukseli.

Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach HiFlow Solutions, odwiedź www.hiflowsolutions.pl.

LinkedIn - <https://www.linkedin.com/company/hiflow-solutions/about/>

Twitter - <https://twitter.com/HiFlowUSA>

YouTube - <https://www.youtube.com/channel/UCJivNaZR3-638-OP6OxqM5A/featured>

Facebook - <https://www.facebook.com/HiFlowUSA/>

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z działem PR, tel. +48 22 333-81-81, e-mail: pr@hiflowsolutions.pl